

证券代码：301326

证券简称：捷邦科技

公告编号：2025-089

捷邦精密科技股份有限公司

关于收到控股孙公司归还财务资助款项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助情况概述

2025年6月16日，捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于向控股孙公司提供财务资助的议案》，同意公司为控股孙公司扬州赛诺高德电子科技有限公司（以下简称“扬州赛诺”）提供总额不超过人民币6,000.00万元（含）的借款，上述额度在财务资助期限范围内可循环滚动使用。财务资助额度的期限为自董事会审议批准之日起12个月，单笔借款期限不超过12个月，借款利率为年化利率3.2%。具体内容详见公司于2025年6月16日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向控股孙公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-045）。

2025年8月27日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于增加向控股孙公司提供财务资助额度的议案》，同意公司向扬州赛诺增加提供不超过人民币3,000.00万元（含）的借款，上述额度在财务资助期限范围内可循环滚动使用，财务资助额度的期限为自本次董事会审议批准之日起12个月，单笔借款期限不超过12个月。借款利率为年化利率3.2%。具体内容详见公司于2025年8月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加向控股孙公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2025-069）。

二、财务资助进展情况

近日，公司收到扬州赛诺归还的上述财务资助本金人民币 9,000.00 万元及利息 792,231.11 元。截至本公告披露之日，扬州赛诺已将本次财务资助的全部本金及利息归还公司，未出现逾期情况。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日